

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为满足生产经营发展需要，拟向招行银行股份有限公司合肥分行申请综合授信，授信金额不超过 3,000 万元，公司实际控制人彭勇、高莲花、赵勇及高新华为该笔贷款提供连带责任保证担保。

为满足生产经营发展需要，公司子公司无锡市华宇光微电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司无锡科技支行申请银行贷款，申请贷款不超过 1,000 万元，公司提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司子公司深圳市华力宇电子科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司及公司实际控制人彭勇、高莲花提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司子公司合肥市华宇半导体有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，公司提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

公司为子公司贷款，提供连带责任保证担保不构成关联交易。

公司实际控制人提供个人连带责任担保构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司为子公司贷款，提供连带责任保证担保不构成关联交易。

公司实际控制人提供个人连带责任担保构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，该事项可豁免按照关联交易的方式进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：无锡市华宇光微电子科技有限公司

成立日期：2018年10月12日

住所：无锡市新吴区漓江路15号

注册地址：无锡市新吴区漓江路15号

注册资本：1,000万元

主营业务：晶圆测试和芯片成品测试业务

法定代表人：高新华

控股股东：池州华宇电子科技股份有限公司

实际控制人：彭勇、高莲花、赵勇、高新华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：池州华宇电子科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：274,282,378.51元

2025年12月31日流动负债总额：118,022,674.99元

2025年12月31日净资产：146,530,605.91元

2025年12月31日资产负债率：46.58%

2025年12月31日资产负债率：46.58%

2025 年营业收入：155,449,087.64 元

2025 年利润总额：43,717,877.40 元

2025 年净利润：38,369,709.85 元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：深圳市华力宇电子科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 25 日

住所：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区新桥东先进制造产业园一号园区 2 栋 501、601

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区新桥东先进制造产业园一号园区 2 栋 501、601

注册资本：2,000 万元

主营业务：晶圆测试和芯片成品测试业务

法定代表人：高莲花

控股股东：池州华宇电子科技股份有限公司

实际控制人：彭勇、高莲花、赵勇、高新华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：池州华宇电子科技股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：354,355,481.49 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：158,804,048.71 元

2025 年 12 月 31 日净资产：123,138,066.43 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：65.25%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：65.25%

2025 年营业收入：107,449,010.37 元

2025 年利润总额：3,199,503.33 元

2025 年净利润：4,012,471.44 元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：合肥市华宇半导体有限公司

成立日期：2021 年 6 月 24 日

住所：安徽省合肥市高新区天堂寨路 66 号

注册地址：安徽省合肥市高新区天堂寨路 66 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：晶圆测试和芯片成品测试业务

法定代表人：彭勇

控股股东：池州华宇电子科技股份有限公司

实际控制人：彭勇、高莲花、赵勇、高新华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：池州华宇电子科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：437,903,824.70 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：158,775,062.67 元

2025 年 12 月 31 日净资产：35,234,771.15 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：91.95%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：91.95%

2025 年营业收入：64,156,220.77 元

2025 年利润总额：-9,930,025.40 元

2025 年净利润：-8,034,658.34 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司为满足生产经营发展需要，拟向招行银行股份有限公司合肥分行申请综合授信，授信金额不超过 3,000 万元，公司实际控制人彭勇、高莲花、赵勇及高新华为该笔贷款提供连带责任保证担保。

为满足生产经营发展需要，公司子公司无锡市华宇光微电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司无锡科技支行申请银行贷款，申请贷款不超过 1,000 万元，公司提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司子公司深圳市华力宇电子科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司及公司实际控制人彭勇、高莲花提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司子公司合肥市华宇半导体有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

母公司为子公司提供连带责任保证担保，有利于促进子公司业务拓展需要，符合公司和全体股东利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，没有明显迹象表明公司可能因担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	426,843,207.54	59.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	66,246,308.56	9.19%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	286,954,777.74	39.79%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日